

B H s e m i c o n

会社名	日本語：ビーエイチセミコン		代表者		日本語：張晏梓 英語：Chang, AnJae	
	英語：BH semicon		業 種		セラミック部品素材 (セラミック, 積層セラミック)	
住所	〒: 403-030 422-1, Cheongcheon-dong, bupyeong-gu, Incheon city					
ホームページ	WWW.bhsemicon.co.kr □英語, □日本語, ■韓国語			代表電話	82-32-522-6655	
				代表FAX	82-32-522-6983	
参加者(1)	日本語：張晏梓 英語：Chang, AnJae		部署/職位	/ 代表理事		
			連絡先			
			メール			
資本金	2,000百万ウォン	売上額(09)	282百万ウォン	輸出額(09)		
設立年度	2005年 11月 8日	従業員	10名	付設研究所	■有り □無し	
技術(品質) 認証事項	1. 技術(品質) 認証品目 : 2. 技術(品質) 認証種類 : ISO 9001					
海外営業部	□有り □無し (海外担当) 日本語 : ■可能 □不可能		通訳支援(商談会)		■必要 □不要	
主な生産製品 サービス製品	1. Multi-Layer Ceramic Parts 2. Ceramic Heater for Semiconductor-Processing Equipment 3. Parts & Materials for LED 4. Ceramic-Polymer Complex Parts 5. Semiconductor Parts & Materials					
会社特徴 ・ 主な事業内容	会社紹介 当社は半導体装置のコア部品であるセラミック部品素材を生産する会社で、2005年11月、セラミック部品素材産業に寄与するため仁川富平公団内に創立されました。優秀な人材と蓄積された技術ノウハウをもとに、初期のHTCC、LTCCセラミック製品を中心に研究開発に注力し、原材料から完成品まで、全ての過程が当社の技術のみで可能になりました。 現在は、ISO9001の認証を受け、品質経営を基盤とした生産体制を確立しており、半導体検査装置のMEMS Probe Card用セラミック基板、映像医療装備のImage Sensor用セラミックパッケージ、ワイパーを最小サイズのパッケージにて製作し、GSP、半導体工程設備の高精密セラミック・ヒターなどの分野で絶えず努力を続けています。 さらに、先端セラミックにおいて世界一になるため、LED、エネルギー分野の部品素材に対する新技術開発にも努力しています。当社は原則と基本を守り、“顧客が信頼できる会社” “最高の品質を維持する会社” “優秀な人材を育てる会社” になるため、最高の技術力と革新的な経営マインドで未来を開拓する企業を目指しています。					

	主な製品 1. LTCC、HTCC基盤 Probe Card用Board開発 2. 半導体Track用セラミック・ヒター開発 保有技術 1. Via Punching & Pattern印刷 ： 現在50μm厚さまで回路パターン及びパターン間隔の実現が可能 2. 焼結温度及び焼結時間 Know-How ： LTCC (800℃~1000℃), HTCC (1500℃~1600℃) 3. Green Sheet 多層直接技術 ： 現在100枚まで積層可能 4. 高精度積層セラミック工程技術 ： 原材料配合で同時焼成まで一括工程技術保有 5. セラミックメッキ及び金属回路形成技術 ： FPCB 工程を適用した微細回路形成技術保有
国内取引実績	- AMST : Probe Card用セラミック基板 - VATECH : 医療用Image sensor用セラミックパッケージ - SEMES : Ceramic hot-plate
海外取引実績	

日本企業との商談希望内容

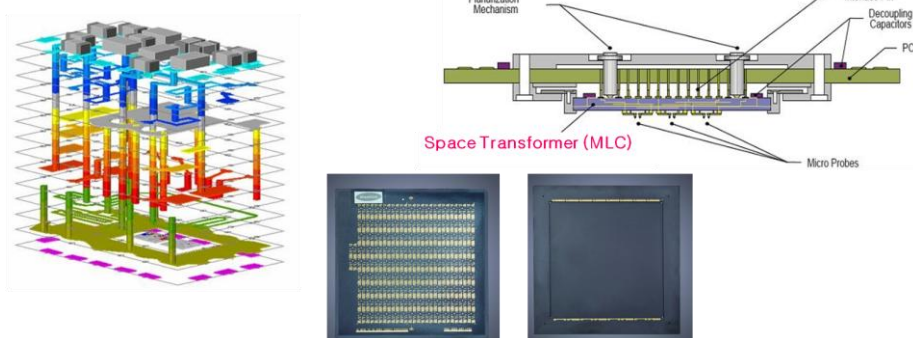
希望商談形態

☒ 輸出
 ☐ 輸入
 ☐ 委託生産/加工
 ☒ 技術取引/提携
 ☐ その他()

商談希望内容

○半導体用のセラミック部品

- 概要： 半導体製造工程が完了したウエハー上にある各々のチップを検査する装置の核心部品。素子の直接回路 via diameterが小さくなりつつあり、回路のfine pitchや高精密積層 align 技術などが要求され、wafer sizeが大型化されていることうけて、8inch工程ラインを確保して製造している。
- 用途： 導体検査装置の Probe Card用積層セラミック基板
- 応用分野： Image Sensor用セラミックパッケージ、趙漠型軽量、趙小型 CSPなど
- 製品の特徴：
 - Size : 8 inch
 - Via Diameter : Min 100 μ m
 - Pad Diameter : Min 120 μ m
 - Line Width : Min 90 μ m
- 製品写真



○高性能セラミック・ヒーター

- 概要： 半導体製造時の真空およびプラズマを利用して感光性樹脂塗布工程や、エッチング及び増着工程でのフェイパーの温度調節はとっても重要な要所であり、均一又は再見性があるウェイパーの温度調節は水率に直接影響を及ぼす。これに対応するために、高温でも変形が少なく、同一な温度を持つセラミック材質のヒターを開発した。
- 用途： 半導体 Track用ヒター
- 製品特徴
 - 素材： AlN
 - 製品の大きさ： $\Phi 315 \times 3.5t$
 - 使用用度： max. 200 $^{\circ}$ C
 - 温度精密度： $\pm 0.5\%$ 이내

4. 製品写真



商談希望業種

- 半導体装備製造分野
- セラミック部品素材分野
- LED製造分野